

高密度同軸構造 B to Bコネクター High Density Coaxial B to B Connector

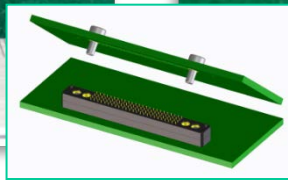
5G技術Massive MIMOやPhased Array Rader等の
GHz・RF回路の基板間接続に最適

新提案

2.54mmピッチ (2X5 千鳥配列)



1.27mmピッチ (2X8)



【特長・用途】

- ・ ソルダレスソリューション、コンプレッションマウントの高周波伝送特性
- ・ 高い信号品質、チャネル間伝送特性の均一性、高再現性
- ・ 高耐久性(5万回)、広い温度仕様(-40~150°C)及び耐振動特性
- ・ チャンネルピッチ 0.8mmで1cm²に100同軸チャンネルのカスタム仕様に対応
- ・ 形状 / サイズ / ピッチ / 配列等のカスタム仕様にも対応
- ・ メンテナンス : 取り外し / 交換 / 再利用が容易

【伝送特性】

- ・ 通過特性 (S21.12) : **-1dB (30GHz)**
- ・ 反射特性 (S11.22) : **-20dB (30GHz)**
- ・ アイソレーション (S31.41) : **-50dB (30GHz)**



お問い合わせはこちらから

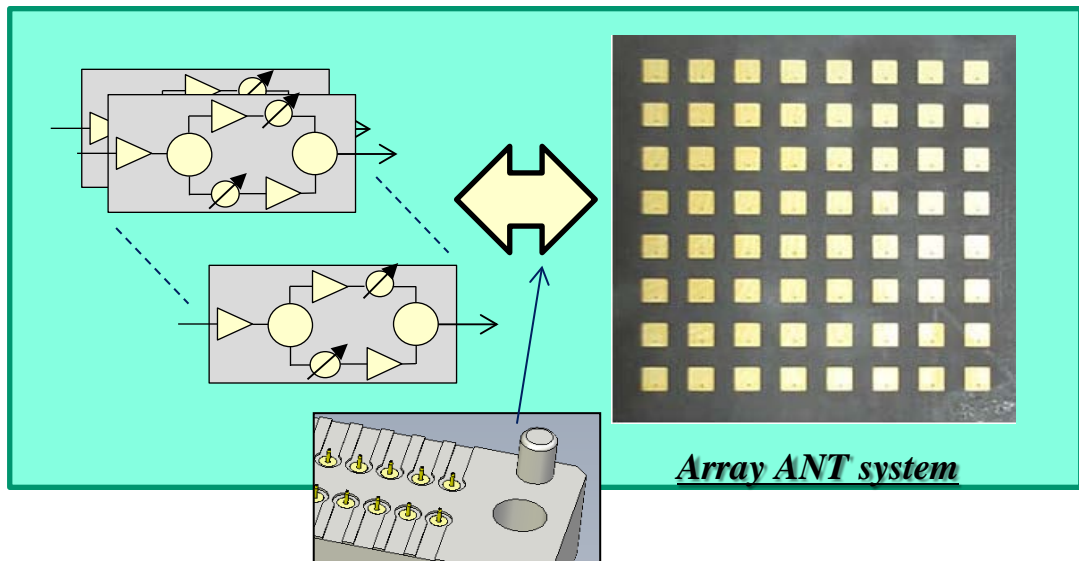
03-5796-0330

We Solve Your Interconnect Challenges.

多チャンネル同軸 基板間 ソルダーレスコネクタ

多チャンネルGHz帯高周波信号の装置内ケーブル接続に変革を

- ・RF回路モジュール/アレイアンテナモジュールの接続
- ・Massive MIMO技術のRF信号接続
- ・装置の小型化に貢献します
- ・ソルダーレスコンプレッションマウント方式の利点
 - 優れたシグナルインテグリティ<70GHz
 - 長期にわたる再現性を実現
 - 歪のない信号伝送を実現
- ・RF-PCBのスペースセービングを実現
 - SMP-MAXと比較して1/3のスペース

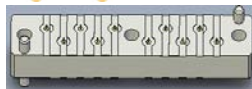


PCB real estate comparing

SMP-MAX
90x10mm



SER's BtoB coax
36x8mm



We Solve Your Interconnect Challenges.